

ABSTRAK

Pengendalian Kualitas Mesin *Wafer Stick* WS4RW Pada PT. X Menggunakan Analisa FMEA dan Metode FTA (Studi Kasus Manufaktur Mesin Wafer)

PT. X ialah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yaitu pembuatan mesin - mesin *food* dan *pharmacy packaging*. Salah satu mesin yang dihasilkan PT. X antara lain Mesin WS4RW. WS4RW adalah mesin pembuat wafer stick. Salah satu yang harus diperhatikan dalam *wafer stick* ialah kualitas rasa, bentuk serta kondisinya. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menerapkan kinerja mesin yang baik, sehingga tidak adanya kecacatan saat produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis *defect* yang paling banyak terjadi dan faktor - faktor apa saja yang menjadi penyebab *defect* pada mesin WS4RW dan upaya perbaikan untuk mengurangi *defect* tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data *defect* yang ada kemudian diolah sehingga terbentuk akar permasalahan dan cara penanggulangannya. Kesimpulan pada penelitian ini adalah *defect* paling banyak terjadi pada bagian *choco head* dan *safety* mesin, faktor – faktor penyebab terjadinya *defect* yaitu tidak hanya pada konstruksi mesin dan juga dikarenakan *human error*.

Kata Kunci : WS4RW, Wafer Stick, Defect.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

ABSTRACT

Wafer Stick WS4RW Quality Control At PT. X Using FMEA Analysis and FTA Method (Wafer Machine Manufacturing Case Study)

PT. X is one of the companies which established in manufacturing of food machinery and pharmacy packaging. One of the engines produced by PT. X is WS4RW Machine. WS4RW is a wafer stick making machine. The requirement that must be considered in the wafer stick is the quality of taste, shape and condition. And the way to achieve is applying good machine performance, so there is no defect during production. The purpose of this study is to determine the type of defect that most occur and what factors are the cause of defects in the WS4RW machine and how to reduce the defect. The research method is to collect defect data which is and then processed to form the root of the problem and how to overcome it. Conclusion in this research is which defect most happened at choco head and safety of machine, cause factors of defect that is not only in machine construction but also because human error.

Keywords : WS4RW, Wafer Stick, Defect.

